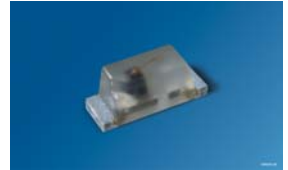


Silicon NPN Phototransistor

NPN-Silizium-Fototransistor

Version 1.0 (not for new design in automotive applications)

SFH 3010



Features:

- **Spectral range of sensitivity:** 420 ... 1100 nm
- **Package:** SmartLED (SCD 80), Epoxy, colourless, slightly diffused
- **Special:** Very small SMT package: (LxBxH) 1.7 mm x 0.8mm x 0.65 mm
- Large viewing angle $\pm 80^\circ$
- Available only on tape and reel

Applications

- Miniature photointerrupters
- Sensor technology (e.g. mobile phone)
- For control and drive circuits

Besondere Merkmale:

- **Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:** 420 ... 1100 nm
- **Gehäuse:** SmartLED (SCD 80), Harz, farblos, leicht diffus
- **Besonderheit:** Sehr kleines SMT-Gehäuse: (LxWxH) 1.7 mm x 0.8mm x 0.65 mm
- Großer Empfangswinkel $\pm 80^\circ$
- Nur gegurtet lieferbar

Anwendungen

- Miniatur Lichtschranken
- Sensorik (z.B. Handy)
- Messen / Steuern / Regeln

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Photocurrent Fotostrom $\lambda = 950 \text{ nm}, E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2, V_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_{PCE} [\mu\text{A}]$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 3010	≥ 25	Q65110A6458

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ °C}$)**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung	V_{CE}	15	V
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung ($t < 2\text{ min}$)	V_{CE}	30	V
Collector current Kollektorstrom	I_C	15	mA
Collector surge current Kollektorspitzenstrom ($\tau < 10\text{ }\mu\text{s}$)	I_{CS}	75	mA
Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung	V_{EC}	7	V
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	130	mW
Thermal resistance junction - ambient ^{1) page 10} Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung <small>1) Seite 10</small>	R_{thJA}	450	K/W
Thermal resistance junction ^{2) page 10} Wärmewiderstand Sperrschicht/Lötstelle ^{2) Seite 10}	R_{thJS}	250	K/W

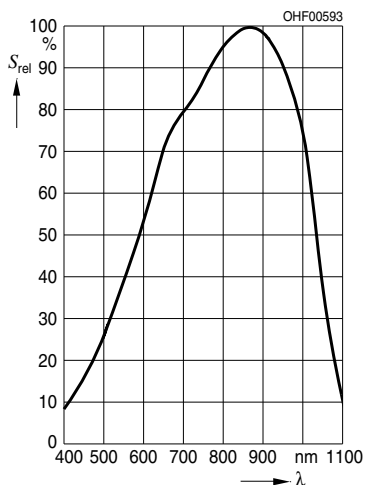
Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{S\text{ max}}$	860	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{10\%}$	420 ... 1100	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	A	0.04	mm ²
Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche	L x W	0.38 x 0.38	mm x mm

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Half angle Halbwinkel	φ	± 80	$^{\circ}$
Capacitance Kapazität ($V_{CE} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $E = 0$)	C_{CE}	1.3	pF
Photocurrent Fotostrom ($\lambda = 950 \text{ nm}$, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$)	I_{PCE}	≥ 25	μA
Dark current Dunkelstrom ($V_{CE} = 20 \text{ V}$, $E = 0$)	I_{CE0}	1 (≤ 50)	nA
Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit ($I_C = 1 \text{ mA}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$)	t_r, t_f	7	μs
Collector-emitter saturation voltage Kollektor-Emitter Sättigungsspannung ($I_C = 10 \mu\text{A}$, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$)	V_{CEsat}	140	mV

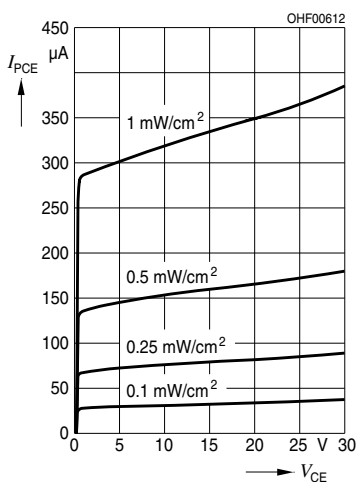
Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit

$$S_{rel} = f(\lambda)$$



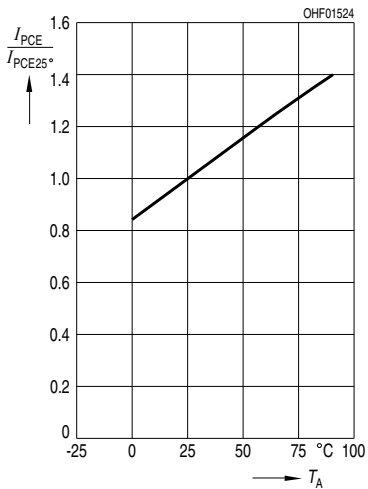
Photocurrent Fotostrom

$$I_{PCE} = f(V_{CE}), E_e = \text{Parameter}$$



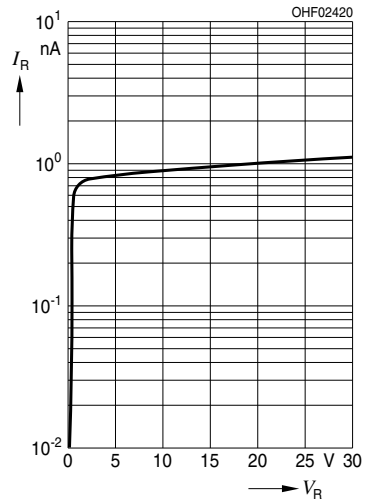
Photocurrent Fotostrom

$$I_{PCE} / I_{PCE}(25^{\circ}\text{C}) = f(T_A), V_{CE} = 5 \text{ V}$$



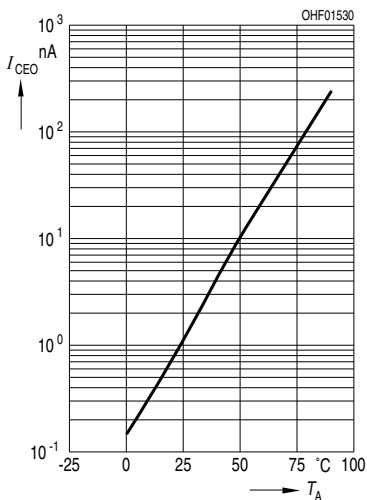
Dark Current Dunkelstrom

$$I_{CEO} = f(V_{CE}), E = 0$$



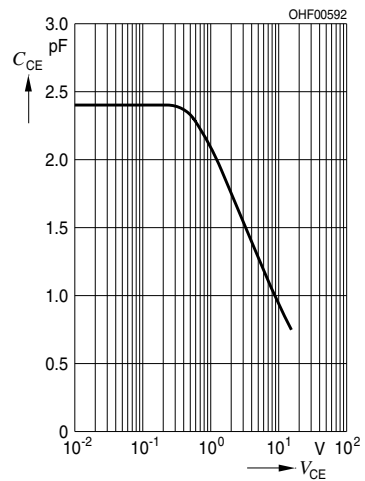
Dark Current Dunkelstrom

$$I_{CEO} = f(T_A), E = 0, V_{CE} = 20 \text{ V}$$



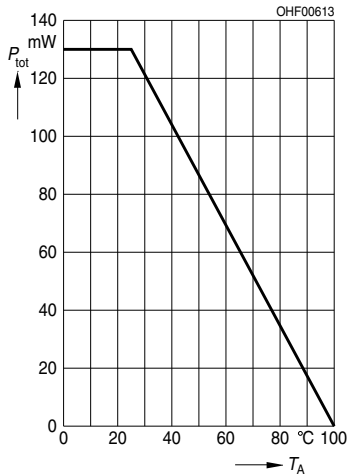
Collector-Emitter Capacitance Kollektor-Emitter Kapazität

$$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$

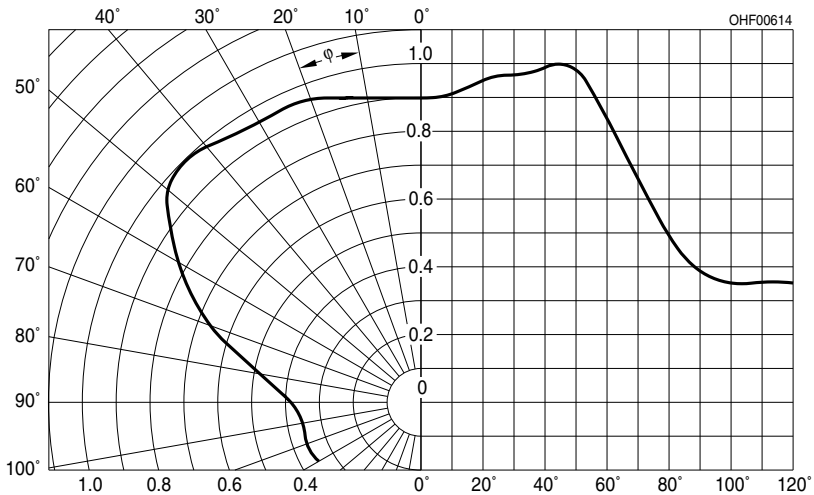


Total Power Dissipation**Verlustleistung**

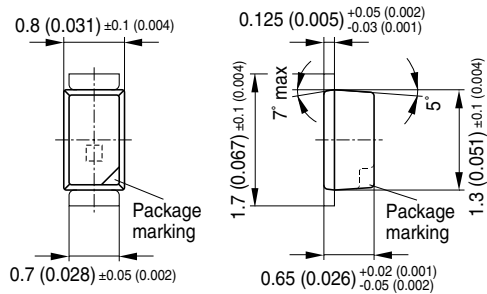
$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$

**Directional Characteristics****Winkeldiagramm**

$$S_{\text{rel}} = f(\varphi)$$



Package Outline
Maßzeichnung



GPLY7036

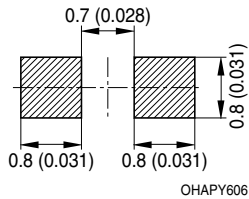
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Additional Information

Zusätzliche Informationen

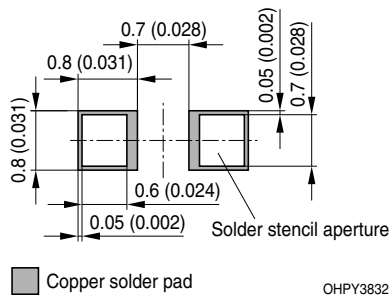
Information	
Package	Epoxy, diffuse
Colour	colourless
Package marking	Collector

Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpadding



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

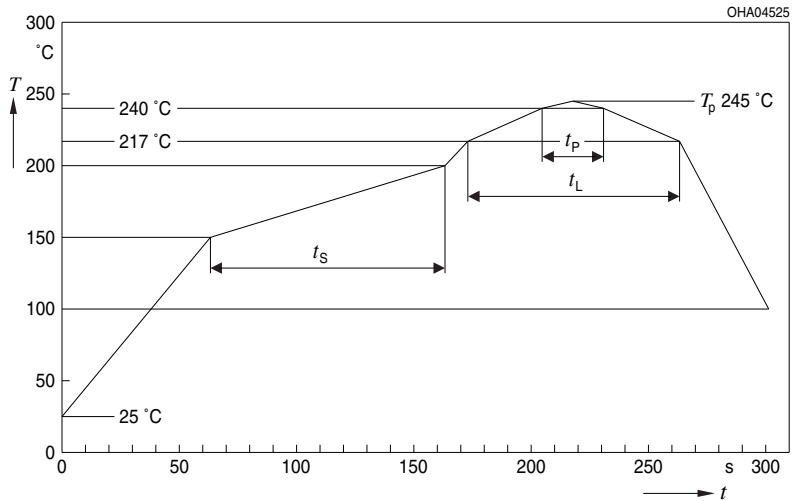
Alternative Solder Pad
Alternatives Lötpadding



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Reflow Soldering Profile**Reflow-Lötprofil**

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_s T_{Smin} to T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_p			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_p		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5$ K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_p to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_p				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Thermal resistance:** junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 5 mm² each
- 2) **Thermal resistance:** junction -soldering point, mounted on metal block

Glossar

- 1) **Wärmewiderstand:** Sperrschicht -Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 5 mm²
- 2) **Wärmewiderstand:** Sperrschicht -Lötstelle, bei Montage auf Metall-Block

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。